Minebea Power Semiconductor Device Inc.

nHPD2 アプリケーションノート



お願い事項;製品検討時には、本アプリケーションノートが最新版であることを確認の上、検討願います。

端子配置

IGBTモジュールの外観を図1に示します。また、回路図を図2に示します。端子をバスバーに接続した際のインダクタンスを軽減するため、DC端子をモジュールの片側に近接して配置し、AC端子をモジュールの反対側にまとめて配置しています。

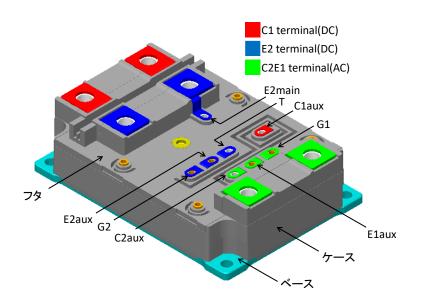
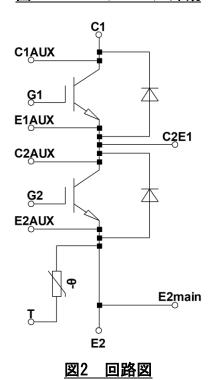


図1 IGBTモジュール外観



IGBTモジュールの断面模式図を図3に示します。モジュールの内部においてC1端子とE2端子は近接してレイアウトされています。これにより、モジュール内部の浮遊インダクタンスを低減しています。

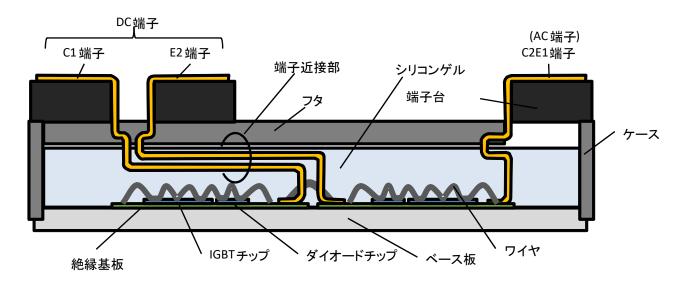


図3 IGBTモジュールの断面模式図